絶縁熱接着フィルム SJ41

Thermo-setting Electrical Isolation Film SJ41

薄膜で優れた接着性能 5μm から提供可能

Thin and strong adhesion, available from 5μm

薄膜で部品の低背化や熱抵抗低減に貢献
Contributes to height reduction and lower thermal resistance with thin thickness

常温で保管可能
Can be stored at room temperature

段差追従性が良好
Excellent adaptability to height differences

用途例 Application

- **受動部品（チップ抵抗器など）**
  Passive components like chip resistor
- **自動車用部品**
  Automotive parts (motor cores, etc.)
- **各種装置部品・治具**
  Various equipment parts and jigs
- **FPC や FFC 等回路基板材料**
  Circuit board materials such as FPC and FFC

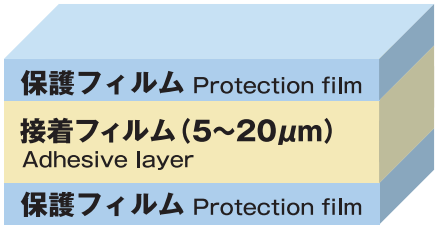
※以下のような素材に適用可能です。
Applicable to following materials lamination.

金属：ステンレス、銅、アルミ、ニッケルなど
Metal: Stainless, Copper, Aluminum, Nickel, etc

樹脂・無機素材：ポリイミド・ガラスエポキシ・FRP・アルミナ・ガラスなど
Resin・Inorganic materials : Polyimide, Glass epoxy, FRP, Alumina, Glass, etc

データおよび層構成 Data and layer structure

特性項目 Items	20μm品 代表値 Data
ピール強度（被着体：SUS304） Peel strength (Adhered material: SUS304)	17N/cm
絶縁破壊電圧（DC） Dielectric breakdown voltage	230KV/mm
吸湿率 Moisture Absorption Rate	0.24% （JIS K7209 D法に準拠） (JIS K7209 D method)
長期耐熱性 Long-term heat resistance	150℃×1,000H ピール強度の低下なし No reduction in peel strength



※ご要望に応じてカスタムも可能です。 Customization available upon request.

TOMOEGAWA
株式会社巴川コーポレーション　iCasカンパニー電子材料事業部
TEL：03-3516-3407　E-mail：eisui_info@tomoegawa.co.jp